

# 首款折叠屏iPhone落地预期升温 产业链公司将受益

日前,中国证券报记者获悉,有苹果产业链公司已于近期开始向首款折叠屏iPhone小批量供货,预计首款折叠屏iPhone于今年秋季发布。机构认为,随着苹果推出首款折叠屏产品,凭借庞大的用户基础,有望提升折叠屏产品市场渗透率,折叠屏产业链公司将受益。

●本报记者 张兴旺

## 折叠屏iPhone潜在市场需求大

据苹果产业链公司相关人士向记者透露,目前公司收到的目标指引显示,首款折叠屏iPhone预计于2026年秋季发布。

对于首款折叠屏iPhone具体发布时间,截至发稿,苹果方面暂无公开回应。

当前,除苹果外,全球其他头部手机厂商早已推出折叠屏手机产品。研究机构IDC数据显示,2025年,全球折叠屏手机市场出货量达到2060万台,同比增长10%;从中国市场来看,2025年,中国折叠屏手机市场出货量约1001万台,同比增长9.2%。

IDC中国高级分析师郭天翔对本报记者分析称,售价贵、售后维修成本高等因素导致折叠屏手机市场规模相对较小。

研究机构Omdia分析师李泽刚对本报记者表示,一方面,相较于传统直板智能手机,折叠屏手机研发与硬件物料成本高,拉高产品定价,直接限制用户规模扩张。另一方面,软件适配尚不完善,产品体验仍有优化空间,如何通过系统设计充分发挥大屏折叠形态的差异化优势,仍是行业需要突破的关键。

研究机构Counterpoint认为,尽管全球折叠屏手机出货量在2025年仅占整体智能手机市场的1.6%,但随着手机厂商寻求高利润机型以对冲入门与中端手机市场的价格压力,该品类对手机厂商的重要性正在上升。随着苹果准备推出其首款折叠屏iPhone,行业竞争格局或将快速变化,2026年折叠屏手机市场将进入新的竞争阶段。折叠屏iPhone的早期需求预计主要来自现有iPhone用户。

业内人士分析称,苹果拥有庞大的用户基础,折叠屏iPhone潜在市场需求广阔,但最终销量将取决于产品体验和售价。2026年,苹果有望进入折叠屏手机市场,叠加各大手机厂商推出多种形态创新产品,行业热度与消费者购买意愿有望迎来新一轮攀升。

## 产业链协同发力

郭天翔认为,苹果入局折叠屏手机赛道,能够吸引更多消费者关注折叠屏产品,激发消费者尝试意愿,同步拉动产业链协同发展。

根据相关机构研报,现有专利显示苹果正在专注于折叠屏的铰链,以及去除屏幕折痕。上海证券研报称,当前折叠屏手机产业链已基本成熟,竞争格局以华为占据国内折叠屏手机市场主导地位,三星占据全球折叠屏手机市场首位。苹果手机拥有较强综合产品力,折叠屏主攻无折痕设计,积极攻克折痕问题,有望带动苹果产业链公司发展。

国盛证券研报称,苹果首款折叠屏手机即将面世,有望拉动

折叠屏手机加速普及,无折痕技术迭代带动量价齐升,为供应链注入新增量。

自折叠屏手机面世以来,屏幕折痕问题是用户体验的痛点。业内人士认为,解决折痕问题不是依赖单一零部件的升级,而是一项涵盖材料、结构、精密制造的系统性工程,需产业链伙伴协同发力。今年3月,OPPO携手上海交通大学、先导智能、安费诺飞凤、铂力特、三星显示等产学研伙伴,共同研究、攻克折叠屏发展中的技术难题。

3月底,先导智能表示,2025年以来,公司与OPPO展开深度合作攻关,将芯片级3D打印技术跨界引入折叠屏手机铰链制造环节,公司成

为OPPO Find N6核心部件供应商,相关芯片级高分子喷墨打印系统成功应用于该机型钛合金天穹铰链的量产制程,有效解决折叠屏折痕控制难题,相关合作已实现小批量交付与验证。

财信证券研报称,UTG(超薄柔性玻璃)与铰链是折叠屏区别于直板手机的核心增量部件,技术壁垒高、价值集中度高。预计苹果于2026年推出首款折叠屏产品,凭借庞大的用户基础,有望提升折叠屏品类的市场接受度,并带动相关供应链需求增长。建议关注折叠屏产业链中UTG、铰链及MIM(金属粉末注射成型)结构件等核心增量环节。

## 产业链公司披露折叠屏业务进展

2025年9月,华兴源创表示,苹果是公司的主要终端客户之一。公司的测试解决方案已经用于苹果公司的手机、平板、手表、耳机、智能音箱等主力产品的测试。经多年稳定合作,公司依托自身研发能力,已与主要终端客户建立稳定的信任壁垒。公司在折叠屏项目上有充足的技术储备。

领益智造是苹果供应商。2026年4月,领益智造表示,在折叠屏终端硬件领域,公司专注于为全球头部客户提供一站式硬件制造及解决方案服务。

鹏鼎控股是苹果iPhone印制电路板供应商,2026年1月,鹏鼎控股

在机构调研时被问及大客户折叠屏手机电路板料号变化时表示,客户该款产品还未上市,不方便给与评价。从新产品的要求看,理论上会对料号条数及部分料号的生产工艺提出更高的要求。

2026年4月,荣旗科技在互动易平台表示,公司参与了苹果折叠屏手机中VC(均热板)散热的外观缺陷检测。

2026年5月,联得装备在互动易平台披露,公司折叠屏超薄柔性玻璃贴附类设备已向行业头部客户实现批量出货。终端客户新品量产节奏存在不确定性,公司不便预判

单一项目对2026年第三、第四季度的业绩弹性与具体贡献。针对下游潜在需求,公司已提前做好产能与供应链配套储备,将根据客户后续需求适时灵活调配产能、保障交付。

## 量子科技长三角产业创新中心： 做量子工程化“修路人” 筑牢产业底层根基

●本报记者 程雪儿

在苏州相城区,量子科技长三角产业创新中心选择了一条少有人走的路:不是止步于科学探索,而是更聚焦把前沿成果转化成为稳定可靠的工程能力,做量子科技工程化的“修路人”。从稀释制冷机实现10毫开尔文量级运行验证,到100比特超导量子计算机的理论潜力,再到推动超导量子计算系统开展国际合作,这家由中国电科与地方政府共建的中心,正在试图为量子科技打造一套从“尺子”到“机器”的底层基础。

### 为什么需要新的“尺子”和“母机”

“以前脖子卡住是喘不上气,现在脚脖子卡住要解决的是走路不方便的问题。”量子中心负责人徐海这样形容当前量子科技面临的核心问题。他所说的“走路不方便”,指向一个长期存在的行业痛点:公共基准、工业母机、测试仪器。

在传统电子工业领域,一个常见的困境是:设备可以引进,产品可以生产,但底层的“度量衡”——公共基准与工业母机,往往不在自己手中。为了避免在量子时代重蹈这种“尺子在外”的覆辙,量子中心从成立第一天起就明确了使命:研制量子领域的工业母机(生产设备的设备),打造公共基准(量子的“米原器”)。

这一思路被该中心领军人物、中国工程院院士陆军概括为“A+B”模型——公共基准加公共母机。中心为此设立了工业母机部、公共基准部、体系理论部等实体部门,拥有近200名技术研发人员,可依托中国电科体系内多家研究所形成协同支撑。

“这不是一个孵化器,我们是一个科研实体。”徐海强调。目前,中心联合中国电科旗下多家研究所的协同力量,在稀释制冷机、测控系统、低温器件等关键环节持续推进自研,形成了一批自主研发和工程验证能力。其中,相关低温系统已实现10毫开尔文量级运行验证,能够支撑超导量子计算实验所需的极低温环境。中心相关人士解释:“量子信号极其微弱,常规电子测量体系中的噪声、漂移和链路误差都可能显著影响测量结果。要准确表征量子系统,必须建立面向量子器件和极低温环境的专用基准与测试体系。”

### 布局超导 与合肥错位协同

量子计算存在多条技术路线。量子中心为什么选择超导?“因为超导是基于传统半导体工艺的。”徐海直言,“制造装备、测试仪器、材料基础,我们中国电科都有积累。”

这是一个清晰的战略判断:超导是目前公认最有可能率先实现工程化突破的路线之一。中心相关人士透露,100比特规模超导量子计算机在特定问题上具备展现量子优势的潜力,但从理论能力到稳定可靠的工程化应用,仍需持续攻关。

徐海特意区分了合肥国家实验室与量子中心的角色:合肥国家实验室侧重前沿科学探索,量子中心侧重工程化验证、关键设备研制和产业化支撑,双方在量子科技从科学突破走向工程应用过程中形成错位协同。

他用一个比喻说明两者的关系:“科学家爬山找路,弯弯曲曲到山顶。我们负责修路,把路固化下来,后面的人才能走。”

去年底,中心与合肥国家实验室保持任务对接和协同合作,并正在推进国家技术创新中心相关申报创建工作。今年推进的重大专项中,不少任务直接来自合肥实验室的实际需求——一些海外供应的设备难以获得,就由量子中心来研制。“我们在做支撑的过程中,也要自己攀一段。只有这样,才知道技术瓶颈的真正痛点在哪。”徐海表示。

正是这种“支撑+自攀”的混合模式,让量子中心在2025年底实现了量子计算系统国际合作的重要突破,中心已推进面向巴西的超导量子计算系统国际合作项目,内容涵盖设备交付、系统集成、培训服务和工程化支撑。

### 从实验室到产业园

在苏州相城区黄埭镇,一块135亩的土地已经动工。这是量子国际科技产业园启动区。

量子国际科技产业园并非单独的园区开发项目。其前期基础来自中国电科、电科院与苏州市、相城区共同建设量子科技长三角产业创新中心的实践。2024年11月11日,中国电科集团与江苏省签署战略合作协议,围绕电子信息、芯片、汽车电子、新域新质等方向深化央地合作,量子科技成为其中重要的未来产业方向。此后,结合国家及江苏省、苏州市关于量子科技产业发展的相关部署,相城区进一步谋划量子国际科技产业园,以量子中心为牵引,承接芯片制造、整机集成、测试验证、成果转化和上下游企业集聚。启动区先行建设,主要解决近期科研成果转化和工程化生产承载问题,远期逐步形成量子科技产业集聚空间。

目前,该中心的产业化平台——中电科量子产业(苏州)有限公司已经成立,负责产品转化与销售。面向巴西项目的设备、正在研发的测控系统、稀释制冷机部件,都将通过这个平台推进市场化转化。

量子科技产业仍处于工程化积累和市场培育阶段,需要重大项目牵引、长期投入支持和持续产品迭代。中心正通过科研任务、产品交付和产业化平台建设,推动技术能力逐步转化为市场能力。真正让地方政府和产业界持续投入的,是量子科技一旦在工程化上取得突破后,对生物医药、先进材料、数字经济等领域的底层算力重塑。苏州生物医药产业基础较好,集聚了一批跨国药企研发机构和创新药企业。未来如专用量子计算在复杂分子模拟等方面取得突破,有望为药物研发、材料设计等领域提供新的算力工具。这不是简单的迭代,而是范式的改变。

但同时,中心相关人士强调,这一切仍处于“从0到1”的工程化积累阶段,远未到规模化应用的时刻。“现在最需要的是耐心和持续投入。”

采访结束前,记者参观了中心的超导量子计算机实验室。多台正在运行的机器发出低频的嗡鸣,稀释制冷机层层嵌套,如俄罗斯套娃般将温度压缩至接近绝对零度。“这个声音,是氦3、氦4在循环。”现场技术人员低声说,“它在寻找平衡点,就像我们整个产业一样——在未知中寻找确定性。”

# A股定增结构性活跃 新兴产业获资本青睐

●本报记者 董添

近期,多家上市公司披露定增方案,其中涉及半导体、生物医药等新兴产业数量较多。从定增认购机构的结构看,国家大基金、地方国资、社保、险资等长线资金频频出现。相比之下,牛散、私募依托定增进行短线套利的行为明显降温。业内人士表示,定增市场投机属性减弱、产业投资属性正在增强。

## 聚焦新兴产业

兴森科技6月23日晚间公告,公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过39亿元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于珠海兴森半导体有限公司高阶MSAP基板智能制造及产业化项目(一期)、珠海兴科半导体有限公司集成电路封装基板项目(三期)、补充流动资金及偿还银行贷款。

对于本次发行的目的,兴森科技在公告中表示,封装基板作为集成电路封装的核心材料之一,随着数据中心、智能驾驶、超算等领域需求持续高速增长,其所需的核心集成电路(CPU、GPU、FPGA、ASIC)市场规模迎来高速增长的机会,市场前景广阔;且受益于国内晶圆产能的扩张和封装产业占全球份额的持续增长,国内对封装基板的需求将会持续提升,本土化的配套需求也会随之提升。

6月23日,江丰电子定增股份正式上市。公司自2025年10月披露定增预案,历

经股东大会审议、深交所审核及证监会注册批复等流程,以181.01元/股发行1065.04万股,实际募资总额约19.28亿元。

中信建投证券分析指出,江丰电子本次定增发行,国投集新(隶属于国家大基金三期)与国调基金参与认购,合计获配约9亿元,占本次募资总额的46.7%。此外,广东省粤财产业科技基金、广州工控混改基金、易方达基金、财通基金、诺德基金等获配。本次最终发行价格为181.01元/股,较发行日收盘价折扣率为96.25%。本次定增是江丰电子在战略维度上向半导体价值链持续迈进的关键一步。韩国生产基地“年产12300个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目”将实现对国际顶尖大厂的近距离属地化覆盖,提升复杂形势下的全球供应链韧性;而配套的“上海江丰电子研发及技术服务中心项目”则依托长三角产业集群优势,布局前沿未量产尖端材料。

### 从“赚价差”转向“赚成长”

知名经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林对本报记者表示,从上市公司定增资金流向看,硬科技与新兴产业更容易获得资本青睐,助力新质生产力发展。半导体设备、电子、AI、算力、储能等领域均获得大量的定增资金支持,也高度契合国家战略导向,呈现出鲜明的结构性分化特征。这种现象和政策的精准扶持是分不开的,定增为上市公司发展和新质生产力发展提供了源源不断的动力,参

与方也实现了从“赚价差”向“赚成长”的转型。

对于当前定增市场的新变化,上海国家会计学院金融系主任叶小杰对中国证券报记者表示,融资端呈现鲜明的“有保有压”导向。契合国家战略的硬科技赛道融资约束适度放宽,资本被精准引导至产业升级的核心环节。业绩持续亏损、募用途频繁变更、存在财务瑕疵或套利减持倾向的企业,审核约束持续强化,市场优胜劣汰功能显著增强。资金端完成了投资逻辑的切换,国家大基金、地方国资、社保与险资等长线产业资本逐步成为认购主力,市场化定价下折价空间持续收窄,以往依赖一二级市场差的套利模式逐渐退场,机构参与的核心目标从赚差价转向分享企业长期成长红利,定增的产业赋能属性得以强化。

### 多家公司终止定增事项

值得一提的是,近期,不少上市公司终止了定增事项。

鑫科材料日前披露关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告。公告显示,公司原计划向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司,发行价格为3.21元/股,发行的股票数量为不超过1.09亿股(含本数),募集资金总额不超过3.5亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。

